

沪士电子股份有限公司

2021年06月08日投资者关系活动记录表

编号：2021-0608-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	摩根大通证券（中国）有限公司
时间	2021年06月08日 上午 11:00-12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	钱元君
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、企业通讯市场板业务</p> <p>从中长期来看，5G通信建设的总趋势不会改变，随着5G应用生态培育和扩展，5G势必成为网络基础建设最大的推手。随着越来越多的信息数据被生成并以更高的速度移动到越来越多的地方，新一代高速网路设备、数据存储、高速运算服务器、人工智能等新兴市场领域有望持续稳健成长。企业通讯市场板领域的行业成长驱动未来也将逐步由5G无线侧向网络设备侧迁移，催生对高频高速PCB产品的的强劲需求，并对技术层次和品质提出高的要求。</p> <p>公司已规划投资新建年产165,000平方米应用于下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板，以进一步完善产业布局，强化高端产品竞争优势。</p> <p>2、汽车板业务情况</p> <p>随着越来越多的电子技术应用到汽车系统，汽车电子已成为衡量现代汽车水平的重要标志，其对汽车板性能和可靠性的要求不断提高，汽车板产业渐变之中蕴涵无限机遇，每辆车所含PCB比率也在持续增长，公司也将持续聚焦，适度扩产，稳步前进，保持并扩大竞争优势，以满足客户的需求。目前全球芯片短缺是个严重问题，但对公司整体汽车板销售额目前未看到负面影响，我们会持续关注客户的需求变化。</p> <p>3、半导体芯片测试板</p>

	<p>半导体芯片测试板的市场对公司来说是个全新的领域，公司已规划投资新建年产6,250平方米应用于半导体芯片测试领域的产能，在新厂建设完毕后，公司希望在5年内追上该领域的先进同行，并在技术水平上进入第一梯队。</p> <p>4、其他</p> <p>目前PCB行业不仅普遍面临原物料涨价，而且由于贸易争端所带来的供应链分散布局需求以及国内PCB同行近年来的大规模投资和产能陆续释放，中国境内PCB行业的竞争激烈程度持续升高。公司原物料供货渠道畅通，在原材料供给上能够获得一定保障。公司和供应商、客户保持紧密的联系，并采取技术工艺创新、产品结构优化等多种手段，共同积极应对成本上涨的风险。</p> <p>此外，公司也会加大在技术和创新方面的投资，以技术质量和服务为客户提供更高的价值；另一方面，公司也会拓展与战略伙伴的合作广度与深度，并进一步完善产业布局，强化高端产品竞争优势，提高客户黏着度，降低客户转移产地的意愿。</p> <p>注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年06月08日